MARKET NEWS

Neue CoolSiC™ MOSFETs 650 V G2 im TOLT- und Thin-TOLL-Gehäuse verbessern die Systemleistungsdichte

München, 3. Juni 2024 – Die Elektronikbranche erlebt einen signifikanten Wandel hin zu kompakteren und leistungsfähigeren Systemen, die durch technologische Fortschritte und den zunehmenden Fokus auf die Dekarbonisierung angetrieben werden. Mit der Einführung der neuen Thin-TOLL 8x8- und TOLT-Gehäuse beschleunigt und unterstützt die Infineon Technologies AG diesen Trend. Die Gehäuse ermöglichen es, das PCB-Mainboard sowie die Tochterkarten maximal auszureizen und berücksichtigen dabei auch die thermischen Anforderungen und Platzbeschränkungen des Systems. Infineon erweitert nun sein Portfolio an diskreten CoolSiC™ MOSFETs 650 V um zwei neue Produktfamilien im Thin-TOLL 8x8- und TOLT-Gehäuse. Sie basieren auf der zweiten Generation (G2) der CoolSiC-Technologie und zeichnen sich durch deutlich verbesserte Figures-of-Merit, eine höhere Zuverlässigkeit und eine bessere Benutzerfreundlichkeit aus. Beide Produktfamilien sind speziell auf hohe und mittlere Frequenzen bei Schaltnetzteilen (SMPS) ausgerichtet, einschließlich KI-Server, erneuerbare Energien, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und große Haushaltsgeräte.

Das Thin-TOLL-Gehäuse hat einen Formfaktor von 8x8 mm und bietet die beste Thermozyklusfähigkeit (Thermal Cycling on Board, TCoB) auf dem Markt. Bei TOLT handelt es sich um ein TSC-Gehäuse (Top-Side-Cooled) mit einem ähnlichen Formfaktor wie TOLL. Beide Gehäusetypen bieten Entwicklerinnen und Entwicklern mehrere Vorteile: Werden sie zum Beispiel in KI- und Server-Netzteilen eingesetzt, verringern sich die Dicke und Länge der Tochterkarten, und es kann ein flacher Kühlkörper verwendet werden. Beim Einsatz in Mikroinvertern, 5G PSU, TV PSU und SMPS reduziert das Thin-TOLL 8x8-Gehäuse die von den Stromversorgungsbauteilen beanspruchte PCB-Fläche auf der Hauptplatine. Parallel dazu hält TOLT die Sperrschichttemperatur der Bauteile unter Kontrolle, denn diese Anwendungen nutzen in der Regel Konvektionskühlung. Die TOLT-Bauteile vervollständigen das Portfolio der industriellen CoolSiC-Bauteile mit Oberseitenkühlung von Infineon, konkret CoolSiC 750 V im Q-DPAK-Gehäuse. Dadurch kann die von SiC-MOSFETs beanspruchte Leiterplattenfläche reduziert werden, sofern die Stromversorgung der Bauteile kein Q-DPAK-Gehäuse erfordert.

Verfügbarkeit

Die CoolSiC MOSFETs 650 V G2 in Thin-TOLL 8x8 und TOLT sind jetzt in $R_{DS(on)}$ von 20, 40, 50 und 60 mΩ erhältlich. Die TOLT-Variante ist zusätzlich mit einem $R_{DS(on)}$ von 15 mΩ verfügbar. Das Portfolio wird bis Ende 2024 um weitere Produkte ergänzt werden. Weitere

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202406-110d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/coolsic-gen2. Infineon wird die CoolSiC MOSFET 650 V Generation 2 auf der PCIM in Nürnberg ausstellen.

Infineon auf der PCIM Europe 2024

Die PCIM Europe findet vom 11. bis 13. Juni 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stände 470 und 169 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf der begleitenden PCIM Conference und den PCIM Foren, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2024 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse
Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202406-110d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com